

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 3月17日

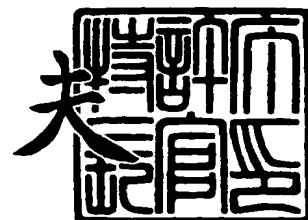
出願番号
Application Number: 特願2003-072860
[ST. 10/C]: [JP 2003-072860]

出願人
Applicant(s): 住友ベークライト株式会社

2004年 3月29日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2004-3025564

【書類名】 特許願

【整理番号】 POE03305

【提出日】 平成15年 3月17日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 C08L 63/00
H01L 23/29

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト
株式会社内

【氏名】 上田 茂久

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト
株式会社内

【氏名】 梅野 邦治

【特許出願人】

【識別番号】 000002141

【住所又は居所】 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号

【氏名又は名称】 住友ベークライト株式会社

【代表者】 守谷 恒夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003539

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

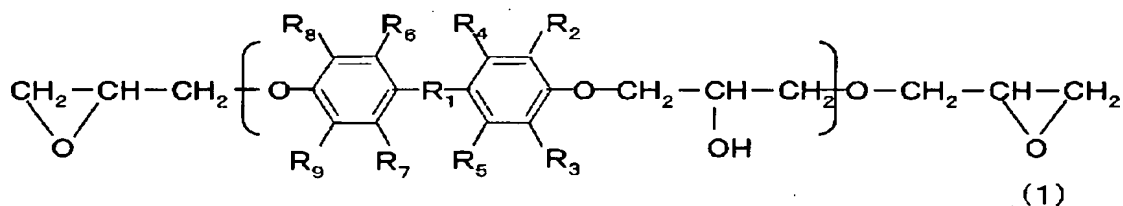
【書類名】 明細書

【発明の名称】 エポキシ樹脂組成物および半導体装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 一般式 (1) で表されるエポキシ樹脂を 50 重量%以上含むエポキシ樹脂 (A)、フェノール樹脂 (B)、全エポキシ樹脂組成物中对し 88～94 重量%の無機充填剤 (C) および硬化促進剤 (D) を主成分とする半導体封止用樹脂組成物において、シランカップリング剤 (E) を全エポキシ樹脂組成物中に 0.01～1.0 重量%、芳香環に 2 個以上の隣接した水酸基を有し、かつ該水酸基以外の置換基を有するか、または有しない化合物 (F) を全エポキシ樹脂組成物中に 0.01～0.3 重量%含むことを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

【化 1】



(R₁は単結合又は炭素数 3 個以下の飽和もしくは不飽和炭化水素。R₂～R₉は水素又は炭素数 4 個までの飽和炭化水素で、互いに同じでも異なっても良い。)

【請求項 2】 請求項 1 記載のエポキシ樹脂組成物を用いて半導体素子を封止してなることを特徴とする半導体装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体封止用エポキシ樹脂組成物およびそれを用いた半導体装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

近年、半導体装置は生産性、コスト、信頼性等のバランスに優れることからエポキシ樹脂組成物を用いて封止されるのが主流となっている。半導体装置の小型

化、薄型化に伴い、封止用エポキシ樹脂組成物に対しては、より一層の低粘度化、高強度化が要求されている。このような背景から、最近のエポキシ樹脂組成物の動向は、より低粘度の樹脂を適用し、より多くの無機充填剤を配合する傾向が強くなっている。また新たな動きとして、半導体装置を実装する際、従来よりも融点の高い無鉛半田の使用が高まってきている。この半田の適用により実装温度を従来に比べ約 2 0 ℃ 高くする必要がある、実装後の半導体装置の信頼性が現状に比べ著しく低下する問題が生じている。このようなことからエポキシ樹脂組成物のレベルアップによる半導体装置の信頼性の向上要求が加速的に強くなってきており、樹脂の低粘度化と無機充填剤の高充填化に拍車がかかっている。

【 0 0 0 3 】

成形時に低粘度で高流動性を維持するためには、熔融粘度の低い樹脂を用いたり（例えば、特許文献 1 参照。）、また無機充填材の配合量を高めるために無機充填剤をシランカップリング剤で表面処理する方法が知られている（例えば、特許文献 2 参照。）。しかし、これらの方法だけでは種々ある要求特性のいずれかしか満足しないものが多く、全ての要求を満足させ広い範囲で適用可能な手法は未だ見出されておらず、これらの方法でも成形時の熔融粘度の低下が不十分であり、流動性と硬化性を損なわず、無機充填剤の配合量を高め信頼性を満足させる更なる技術が求められていた。

【 0 0 0 4 】

【特許文献 1】

特開平 7 - 1 3 0 9 1 9 号公報（第 2 ～ 5 頁）

【特許文献 2】

特開平 8 - 2 0 6 7 3 号公報（第 2 ～ 4 頁）

【 0 0 0 5 】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、成形時の硬化性を損なうことなく流動性に優れた半導体封止用樹脂組成物を提供するものである。

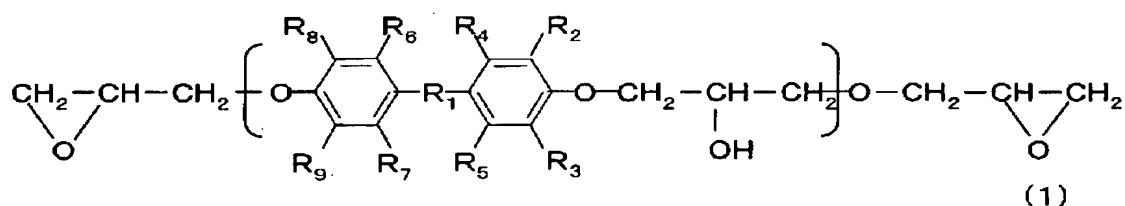
【 0 0 0 6 】

【課題を解決するための手段】

本発明は、

【1】 一般式（1）で表されるエポキシ樹脂を50重量%以上含むエポキシ樹脂（A）、フェノール樹脂（B）、全エポキシ樹脂組成物中に対し88～94重量%の無機充填剤（C）および硬化促進剤（D）を主成分とする半導体封止用樹脂組成物において、シランカップリング剤（E）を全エポキシ樹脂組成物中に0.01～1.0重量%、芳香環に2個以上の隣接した水酸基を有し、かつ該水酸基以外の置換基を有するか、または有しない化合物（F）を全エポキシ樹脂組成物中に0.01～0.3重量%含むことを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物、

【化2】



（R₁は単結合又は炭素数3個以下の飽和もしくは不飽和炭化水素。R₂～R₉は水素又は炭素数4個までの飽和炭化水素で、互いに同じでも異なっても良い。） 【0007】

【2】 第【1】項記載のエポキシ樹脂組成物を用いて半導体素子を封止してなることを特徴とする半導体装置、である。

【0008】

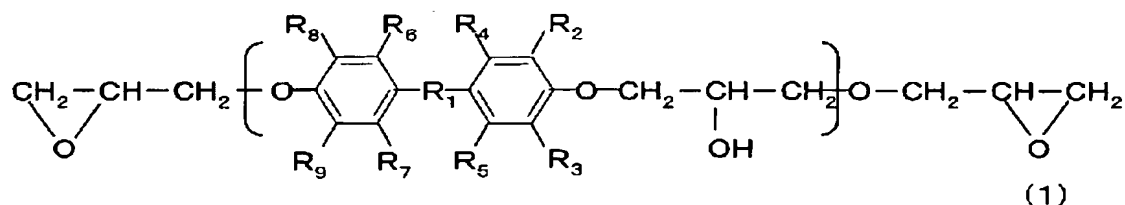
【発明の実施の形態】

以下、各成分について説明する。

本発明に用いるエポキシ樹脂（A）は一般式（1）で表されるエポキシ樹脂を50重量%以上含むものである。一般式（1）で表されるエポキシ樹脂としては、例えばビフェニル型エポキシ樹脂、ビスフェノール型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂等が挙げられ、これらに例えばフェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、トリフェノールメタン型エポキシ樹脂、フェノールアラルキル（フェニレン骨格、ビフェニレン骨格を含む）型

エポキシ樹脂、ナフトール型エポキシ樹脂、アルキル変性トリフェノールメタン型エポキシ樹脂、トリアジン核含有エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン変性フェノール型エポキシ樹脂等を併用することができる。半導体封止用エポキシ樹脂組成物としての耐湿信頼性を考慮すると、イオン性不純物であるNaイオンやClイオンが極力少ない方が好ましく、硬化性の点からエポキシ当量としては100～500 g/e qが好ましい。

【化3】



(R₁は単結合又は炭素数3個以下の飽和もしくは不飽和炭化水素。R₂～R₉は水素又は炭素数4個までの飽和炭化水素で、互いに同じでも異なっても良い。)

【0009】

本発明に用いるフェノール樹脂(B)は、特に限定しないが、例えばフェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、トリフェノールメタン樹脂、テルペン変性フェノール樹脂、ジシクロペンタジエン変性フェノール樹脂、フェノールアラルキル樹脂(フェニレン骨格、ビフェニレン骨格を含む)、ナフトールアラルキル樹脂(フェニレン骨格、ビフェニレン骨格を含む)等が挙げられ、これらは単独で用いるかもしくは併用することができる。硬化性の点から水酸基当量は90～250 g/e qが好ましい。

【0010】

本発明に用いる無機充填剤(C)としては、一般に封止材料に用いられている熔融シリカ、球状シリカ、結晶シリカ、アルミナ、窒化珪素、窒化アルミ等が挙げられる。無機充填剤の粒径としては、金型への充填性を考慮すると150 μm以下であることが望ましい。また充填量としては全エポキシ樹脂組成物に対して88～94重量%が好ましく、下限値未達だとエポキシ樹脂組成物の硬化物の吸水量が増加し、強度が低下するため耐半田性が不満足で、上限値を越えると流動性が損なわれるために成形性に不具合を生じ好ましくない。

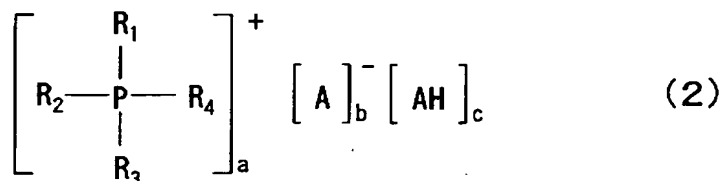
【0011】

本発明に用いる硬化促進剤 (D) は、エポキシ樹脂のエポキシ基とフェノール樹脂の水酸基との反応を促進するものであればよく、一般に半導体素子の封止材であるエポキシ樹脂組成物に使用されているものを利用することができる。具体例として有機ホスフィン、テトラ置換ホスホニウム化合物、ホスホベタイン化合物等のリン原子含有化合物、1, 8-ジアザビシクロ (5, 4, 0) ウンデセン-7、ベンジルジメチルアミン、2-メチルイミダゾール等の窒素原子含有化合物が挙げられる。有機ホスフィンとしては、例えばエチルホスフィン、フェニルホスフィン等の第1ホスフィン、ジメチルホスフィン、ジフェニルホスフィン等の第2ホスフィン、トリメチルホスフィン、トリエチルホスフィン、トリブチルホスフィン、更に1個が長鎖アルキル基であるトリアルキルホスフィン、トリフェニルホスフィン、アルキルジフェニルホスフィン、ジアルキルフェニルホスフィン等の第3ホスフィンが挙げられる。テトラ置換ホスホニウム化合物としては、一般式 (2) に示す化合物が挙げられる。一般式 (2) に示す化合物は、例えばテトラ置換ホスホニウムブロマイドと芳香族有機酸と塩基を有機溶剤に混ぜ均一に混合し、その溶液系内に芳香族有機酸アニオンを発生させる。次いで水を加え一般式 (2) に示す化合物を沈殿させることにより得られる。一般式 (2) に示す化合物としては、リン原子に結合する R_1 、 R_2 、 R_3 および R_4 がフェニル基であり、かつ AH はヒドロキシル基を芳香環に有する化合物、すなわちフェノール類であり、かつ A は該フェノール類のアニオンであるのが好ましい。ホスホベタイン化合物としては、一般式 (3) に示す化合物が挙げられる。一般式 (3) に示す化合物は、例えば沃化フェノール類とトリ芳香族置換ホスフィンとを有機溶媒に均一に混合し、ニッケル触媒によりヨードニウム塩として沈殿させる。このヨードニウム塩と塩基を有機溶剤に均一に混合し、必要により水を加え一般式 (3) に示す化合物を沈殿させることにより得られる。一般式 (3) に示す化合物としては、好ましくは X が水素またはメチル基であり、かつ Y が水素またはヒドロキシル基であるのが好ましい。しかしこれらに限定されるものではなく、単独でも併用してもよい。本発明に用いる硬化促進剤の配合量は、全エポキシ樹脂組成物中 0.1 ~ 0.6 重量% が好ましく、下限値未満だと目的とする硬化性が得

られず、上限値を越えると流動性が損なわれるおそれがあり好ましくない。

【0012】

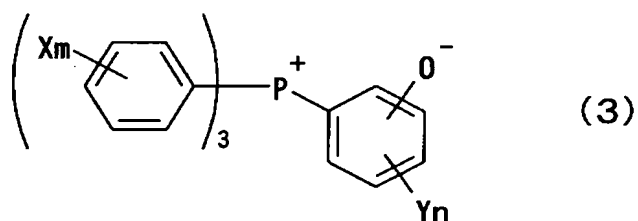
【化4】



(Pはリン原子を表す。R₁、R₂、R₃およびR₄は置換もしくは無置換の芳香族基、またはアルキル基を表す。Aはヒドロキシル基、カルボキシル基、チオール基から選ばれる官能基のいずれかを芳香環に少なくとも1つ有する芳香族有機酸のアニオンを表す。AHはヒドロキシル基、カルボキシル基、チオール基のいずれかを芳香環に少なくとも1つ有する芳香族有機酸を表す。a、b、cは1～3の整数であり、かつa=bである。)

【0013】

【化5】



(Xは水素または炭素数1～3のアルキル基、Yは水素またはヒドロキシル基を表す。m、nは1～3の整数。)

【0014】

本発明に用いるシランカップリング剤(E)は、エポキシシラン、アミノシラン、ウレイドシラン、メルカプトシラン等特に限定せず、エポキシ樹脂組成物と無機充填剤との間で反応し、エポキシ樹脂組成物と無機充填剤の界面強度を向上させるものであればよい。本発明に用いる芳香環に2個以上の隣接した水酸基を有し、かつ該水酸基以外の置換基を有するか、または有しない化合物(F)(以下化合物(F)と称する)はシランカップリング剤(E)との相乗効果により、

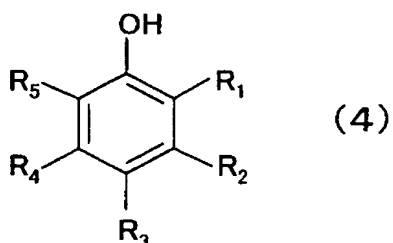
粘度特性と流動特性を著しく改善させるため、シランカップリング剤 (E) は化合物 (F) の効果を十分に得るためには必須である。これらのシランカップリング剤 (E) は単独でも併用してもよい。本発明に用いるシランカップリング剤 (E) の配合量は、全エポキシ樹脂組成物中 0.01~1 重量%、好ましくは 0.05~0.8、特に好ましくは 0.1~0.6 重量%であり、下限値未満だと化合物 (F) の効果が十分に得られず、また半導体パッケージにおける耐半田性が低下する恐れがある。また、上限値を越えるとエポキシ樹脂組成物の吸水性が大きくなり、やはり半導体パッケージにおける耐半田性が低下する恐れがあり好ましくない。

【0015】

本発明に用いる芳香環に 2 個以上の隣接した水酸基を有し、かつ該水酸基以外の置換基を有するか、または有しない化合物 (F) (以下化合物 (F) と称する) としては、一般式 (4) または一般式 (5) で表される化合物が好ましく、例えば、カテコール、ピロガロール、没食子酸、没食子酸エステル、1,2-ジヒドロキシナフタレン、2,3-ジヒドロキシナフタレンおよびこれらの誘導体が挙げられる。そのうち制御のしやすさ、低揮発性の点から母核はナフタレン環である化合物 (1,2-ジヒドロキシナフタレン、2,3-ジヒドロキシナフタレンおよびその誘導体) がより好ましい。これらの化合物 (F) は 2 種以上併用してもよい。かかる化合物 (F) の配合量は全エポキシ樹脂組成物中 0.01~0.3 重量%である。下限値未満だとシランカップリング剤 (E) との相乗効果による期待するような粘度特性および流動特性が得られない。上限値を越えるとエポキシ樹脂組成物の硬化が阻害され、また硬化物の物性が劣り、半導体封止樹脂としての性能が悪化するので好ましくない。

【0016】

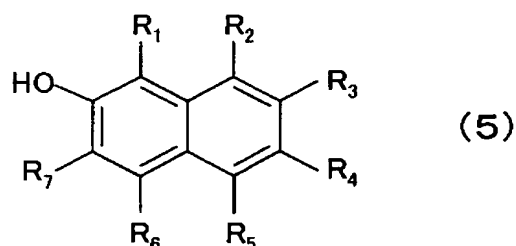
【化6】



(R₁、R₅はどちらか一方が水酸基であり、片方が水酸基のとき他方は水素、水酸基または水酸基以外の置換基。R₂、R₃、R₄は水素、水酸基または水酸基以外の置換基。)

【0017】

【化7】



(R₁、R₇はどちらか一方が水酸基であり、片方が水酸基のとき他方は水素、水酸基または水酸基以外の置換基。R₂、R₃、R₄、R₅、R₆は水素、水酸基または水酸基以外の置換基。)

【0018】

本発明のエポキシ樹脂組成物は、(A)～(F)成分を必須成分とするが、これ以外に必要に応じて臭素化エポキシ樹脂、三酸化アンチモン等の難燃剤、離型剤、カーボンブラック等の着色剤、シリコンオイル、シリコンゴム等の低応力添加剤、無機イオン交換体等の添加剤を適宜配合してもよい。

本発明のエポキシ樹脂組成物は、(A)～(F)成分およびその他の添加剤等をミキサー等で用いて常温で均一に混合した後、加熱ロールまたはニーダー、押出機等で熔融混練し、冷却後粉碎して製造することができる。

本発明のエポキシ樹脂組成物を用いて、半導体素子を封止し、半導体装置を製造するには、トランスファーモールド、コンプレッションモールド、インジェクションモールド等の成形方法で成形硬化すればよい。

【0019】

以下、本発明を実施例にて具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によりなんら限定されるものではない。配合割合は重量部とする。

実施例 1

ビフェニル型エポキシ樹脂（ジャパンエポキシレジン（株）・製、YX4000H、エポキシ当量195、融点105℃）	4.75重量部
フェノールアラルキル樹脂（三井化学（株）・製、XLC-LL、水酸基当量174、軟化点79℃）	4.25重量部
球状溶融シリカ（平均粒径30 μ m）	90.0重量部
γ -グリシジルプロピルトリメトキシシラン	0.3重量部
トリフェニルホスフィン	0.15重量部
2,3-ジヒドロキシナフタレン（試薬）	0.05重量部
カルナバワックス	0.2重量部
カーボンブラック	0.3重量部

をミキサーにて常温混合し、80～100℃の加熱ロールで溶融混練し、冷却後粉碎し、エポキシ樹脂組成物を得た。評価結果を表1に示す。

【0020】

スパイラルフロー：EMMI-1-66に準じた金型を用い、前記エポキシ樹脂組成物を低圧トランスファー成形機にて175℃、成形圧6.9MPa、保圧時間120秒の条件で成形し測定。スパイラルフローは、流動性のパラメータであり、数値が大きい方が流動性が良好である。単位はcm。

硬化トルク比：キュラストメーター（オリエンテック（株）・製、JSRキュラストメーターIVPS型）を用い、金型温度175℃、加熱開始90秒後、300秒後のトルクを求め、硬化トルク比：（90秒後のトルク）／（300秒後のトルク）を計算した。キュラストメーターにおけるトルクは熱剛性のパラメータであり、硬化トルク比の大きい方が硬化性が良好である。単位は%。

耐半田リフロークラック性：低圧トランスファー成形機を用いて、ボディーサイズ $14 \times 20 \times 2.7$ mm の 80 p QFP (Cu フレーム) に $7 \times 7 \times 0.35$ mm の Si チップを接着したフレームを金型温度 175°C 、注入時間 10 sec、硬化時間 90 sec、注入圧 9.8 MPa で成形し、 175°C 8 hr の条件で後硬化後 85°C 85% 168 hr の条件で加湿処理し、ピーク温度 260°C の IR リフローに連続 3 回 (255°C 以上が 10 秒 \times 3 回) 通し、超音波探傷機を用いて内部クラック、剥離の有無を測定し、10 パッケージ中のチップ剥離と内部クラックの数で判定した。

難燃性：低圧トランスファー成形機を用いて、金型温度 175°C 、注入時間 15 sec、硬化時間 120 sec、注入圧 9.8 MPa で 3.2 mm 厚の難燃試験片を成形し、UL 94 の規格に則り難燃試験を行った。

【0021】

実施例 2 ～ 13、比較例 1 ～ 14

表 1 および表 2 の配合に従い、実施例 1 と同様にしてエポキシ樹脂組成物を製造し、実施例 1 と同様にして評価した。評価結果を表 1 および表 2 に示す。

実施例 1 以外で用いた成分について、以下に示す。

ビスフェノール A 型エポキシ樹脂 (ジャパンエポキシレジン (株) 製、エポキシ当量 172、 25°C 熔融粘度 45 mPa \cdot sec)

クレゾールノボラック型エポキシ樹脂 (日本化薬 (株) 製 EOCN1020-55、エポキシ当量 198、軟化点 55°C)

フェノールノボラック樹脂 (水酸基当量 104、軟化点 80°C)

フェノールビフェニルアラキル樹脂 (明和化成 (株) 製、MEH-7851SS、水酸基当量 203、軟化点 65°C)

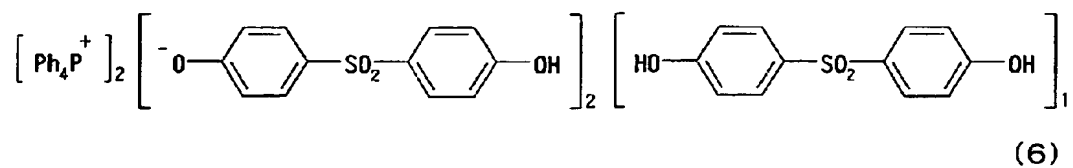
γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン

1, 8-ジアザビシクロ (5, 4, 0) ウンデセン-7 (以下、DBU と略す)

【0022】

式 (6) で示される硬化促進剤

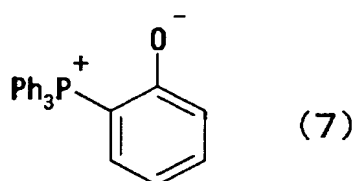
【化 8】



【0023】

式 (7) で示される硬化促進剤

【化 9】



【0024】

1, 2-ジヒドロキシナフタレン (試薬)

カテコール (試薬)

ピロガロール (試薬)

1, 6-ジヒドロキシナフタレン (試薬)

レゾルシノール (試薬)

【0025】

【表 1】

表 1

	実 施 例												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ビフェニル型エポキシ樹脂	4.75	2.45		5.45	4.78	4.45	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.73	4.73
フェノールアラキル樹脂	4.25	4.17			4.22	3.98	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.22	4.22
ビスフェノールA型エポキシ樹脂			3.4										
クレゾールノボラック型エポキシ樹脂		2.44											
フェノールノボラック樹脂			1.96										
フェノールビフェニルアラキル樹脂				5.55									
溶融球状シリカ	90.0	90.0	93.5	88.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
γ-グリジシジルプロピルトリメトキシシラン	0.3	0.3	0.5	0.2	0.05	0.85	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン										0.3			
トリフェニルホスフィン	0.15	0.1	0.12	0.2	0.2	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15		
DBU										0.15			
式(6)の硬化促進剤											0.2		
式(7)の硬化促進剤												0.2	
2,3-ジヒドロキシナフタレン	0.05	0.04	0.02	0.1	0.25	0.02				0.05	0.05	0.05	0.05
1,2-ジヒドロキシナフタレン							0.05						
カテコール								0.05					
ピロガロール									0.05				
1,6-ジヒドロキシナフタレン													
レゾルシノール													
カルナバワックス	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
カーボンブラック	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
スパイラルフロー	100	98	73	102	110	95	102	111	115	105	98	121	105
硬化トルク比	63	61	65	58	60	65	61	60	59	62	58	67	65
耐半田クラック性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部クラック	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
難燃性	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0

【 0 0 2 6 】

【 表 2 】

表 2

	比較例													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ビフェニル型エポキシ樹脂	4.78	1		5.9	4.78	4.6	4.82	4.77	4.9	4.75	4.75	4.78	4.75	4.75
フェノールアラキル樹脂	4.27	4.17			4.27	4.05	4.3	4.27	4.4	4.25	4.25	4.27	4.25	4.25
ビスフェノールA型エポキシ樹脂			2.3											
クレゾールノボラック型エポキシ樹脂		3.89												
フェノールノボラック樹脂			1.3											
フェノールビフェニルアラキル樹脂				6.1										
溶融球状シリカ	90.0	90.0	94.5	87.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
γ-グリシジルプロピルトリメトキシシラン	0.3	0.3	0.5	0.2		0.3	0.3	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン					0.3									
トリフェニルホスフィン	0.15	0.1	0.12	0.2	0.15	0.2	0.08	0.15	0.15	0.15	0.15			
DBU												0.15		
式(6)の硬化促進剤													0.2	
式(7)の硬化促進剤														0.2
2,3-ジヒドロキシナフタレン		0.04	0.02	0.1		0.35		0.008	0.05					
1,2-ジヒドロキシナフタレン														
カテコール														
ピロガロール														
1,6-ジヒドロキシナフタレン										0.05				
レゾルシノール											0.05			
カルナバワックス	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
カーボンブラック	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
スバイラルフロー	65	41	13	108	68	115	120	69	66	67	66	68	79	82
硬化トルク比	65	62	64	55	64	30	10	65	59	65	64	58	67	65
耐半田クラック性	3	10	成形不可		2	離型不良		2	8	4	3	3	2	4
チップ剥離				1			離型不良		0	0	0	0	0	0
内部クラック	0	0		5	0		V-0		V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0
難燃性	V-0	V-0		V-1	V-0	V-0	V-0		V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0

【 0 0 2 7 】

【発明の効果】

本発明に従うと、従来技術では得られなかった硬化性を損なうことなく成形時の流動性に優れたエポキシ樹脂組成物を得ることができる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 硬化性を損なうことなく流動性に優れた特性を有する半導体封止用エポキシ樹脂組成物を提供すること。

【解決手段】 特定構造を有する二官能のエポキシ樹脂が 5 0 重量%以上含むエポキシ樹脂 (A)、フェノール樹脂 (B)、全エポキシ樹脂組成物中に対し 8 8 ~ 9 4 重量%の無機充填剤 (C) および硬化促進剤 (D) を主成分とする半導体封止用樹脂組成物において、シランカップリング剤 (E) を全エポキシ樹脂組成物中に 0. 0 1 ~ 1 重量%、芳香環に 2 個以上の隣接した水酸基を有し、かつ該水酸基以外の置換基を有するか、または有しない化合物 (F) を全エポキシ樹脂組成物中に 0. 0 1 ~ 0. 3 重量%含むことを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物及び半導体装置。

特願 2 0 0 3 - 0 7 2 8 6 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 2 1 4 1]

1. 変更年月日	2 0 0 2 年 1 2 月 1 1 日
[変更理由]	住所変更
住 所	東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号
氏 名	住友ベークライト株式会社